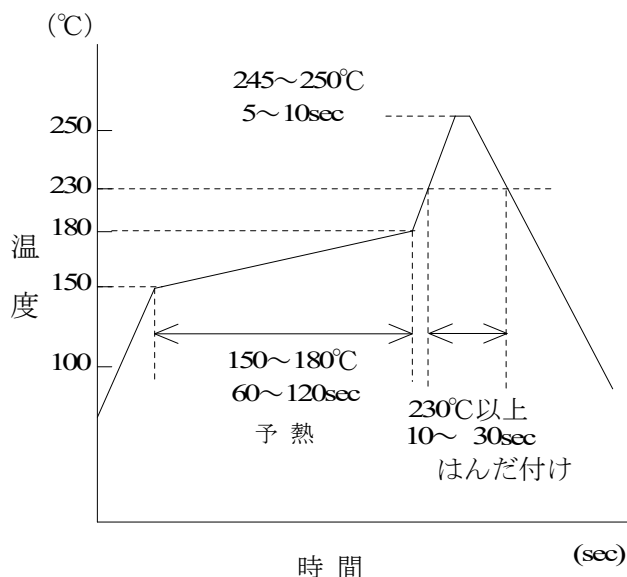


1. 実装条件（鉛フリーはんだの場合）

1-1. リフローはんだ付け

推奨リフロー条件は下図の通りです。



- 注意
1. 温度プロファイルは部品表面で測定して下さい。
 2. リフロー回数は、2回までにして下さい。

1-2. フローはんだ付け

フロー条件は以下の通りです。

プリヒート温度：150°C～180°C／60～120秒

ピーク温度：260±5°C

浸漬時間：10±1秒

はんだ付け回数：1回

※チップ抵抗ネットワークはフローはんだ付け不可とさせていただきます。

1-3. 手はんだ付け

弊社の推奨手はんだ付け条件は以下の通りです。

コテ先温度：350°Cmax.

加熱時間：3秒以内

※上記は推奨条件ですので、事前にお客様の実際の基板で十分にご確認下さい。